

中信证券股份有限公司
关于龙芯中科技术股份有限公司
2024 年半年度持续督导跟踪报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“龙芯中科”或“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本持续督导半年度跟踪报告。

一、持续督导工作概述

1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查的工作要求。

2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。

3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续督导工作，并于 2024 年 9 月 3 日对公司进行了现场检查。

4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责，具体内容包括：

（1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料；

（2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度；

（3）查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关内部审议文件、信息披露文件；

（4）查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账，对募集资金专户执行函证程序；

(5) 对公司高级管理人员进行访谈；

(6) 对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行公开信息查询；

(7) 查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况；

(8) 通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与发行人相关的媒体报道情况。

二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题。

三、重大风险事项

本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

(一) 业绩大幅下滑或亏损的风险

集成电路设计企业的经营业绩受下游市场波动影响较大。如果公司不能及时提供满足市场需求的产品和服务，或下游市场需求发生重大不利变化，公司可能面临业绩下滑的风险。

政策性相关业务受相关政策及市场波动影响较大，当需求大幅降低或延后时，公司将面临业绩下滑的风险。

(二) 核心竞争力风险

核心技术是公司的核心竞争力，公司存在由于核心技术人员流失、专利保护措施不力等原因导致的核心技术泄密或被他人盗用的风险。如果公司未能持续加强对技术人才的培养、激励和保护力度，公司将面临技术人才流失的风险。随着产品制程工艺和复杂程度的不断提高，公司的流片费用大幅上涨，投入的人力、物力亦将随之增加。如果未能把握好投入节奏，亦或产品开发失败，将为公司带来经营业绩下滑的风险。

(三) 经营风险——供应商集中的风险

公司经营主要采用 **Fabless** 模式。公司主要负责芯片的设计工作，生产性采购主要包括芯片加工服务及电子元器件等原材料采购。报告期内公司主力芯片产品的加工服务主要供应商，采购金额占比较高。未来若国际政治经济局势剧烈变动或供应商产能紧张加剧，芯片加工服务的供应可能无法满足公司需求，公司将面临采购价格上涨或供货周期延长的风险，对公司生产经营产生一定的不利影响。

（四）财务风险

1、应收账款导致的坏账风险

公司报告期末的应收账款规模较大，加大了公司的经营风险。如果宏观经济形势恶化或者客户自身发生重大经营困难，公司可能面临应收账款回收困难的风险，公司将会按照会计政策后续计提坏账准备，可能会对公司的盈利能力产生不利影响。

2、存货跌价风险

公司根据已有客户订单需求以及对市场未来需求的预测制定采购和生产计划。截至到报告期期末，公司存货账面价值较高，公司按照会计政策已计提了 **5,560.56** 万元的存货跌价准备，计提后的存货账面价值为 **9.70** 亿元，对公司流动资金占用较大。若未来市场环境发生变化、竞争加剧或技术更新迭代，可能会形成存货积压，公司将会进一步计提存货跌价准备，进而对公司的盈利能力产生不利影响。

3、研发投入相关的风险

作为技术密集型企业，公司坚持核心技术自主创新的发展战略，报告期内研发投入金额较高，部分研发投入形成了开发支出，后续将转入无形资产。若公司研究成果的产业化应用不及预期，可能对公司的经营产生不利影响。

4、政府补助变化的风险

集成电路设计产业受到国家产业政策的鼓励和支持。如果公司未来不能持续获得政府补助或政府补助显著降低，则可能会对公司盈利产生一定的不利影响。

（五）行业风险——市场竞争风险

公司致力于打造独立于 Wintel 体系与 AA 体系的自主生态体系，可能引起竞争对手的高度重视，使得行业竞争加剧。公司面临市场竞争加剧的风险。

公司基于信息系统和工控系统两条主线开展产业生态建设，产品主要销售于关键信息基础设施自主化领域。在全球计算机领域，CPU 商用市场基本被 Intel、AMD 两家占据，面对龙头企业带来的竞争压力，公司可能在激烈的行业竞争中处于不利地位。

（六）宏观环境风险

美国不断出台针对中国高科技半导体企业的出口管制政策，经济全球化受到较大挑战，对全球半导体市场和芯片供应链稳定带来不确定风险。可能对公司的生产经营造成不利影响。

（七）其他重大风险——知识产权纠纷的风险

公司所从事的处理器及配套芯片设计业务涉及大量的知识产权及各种知识产权相关的许可、授权、转让等。其通常较为复杂，涉及境内、外多个法域，适用范围、使用方式、可执行性甚至有效性都可能遇到法律挑战，其中一些可能会演变为诉讼、仲裁、调查、制裁、保全措施等法律程序。在涉及该等法律程序时，公司有可能因此而支出高额法律费用开支。更进一步的，由于该等法律程序通常涉及境内外多个法域，时间周期较长，亦有可能被各种法律或法律之外的因素所影响，当该等法律程序的最终结果对公司不利时，则有可能导致公司面临向对方或与该等知识产权有关的第三方支付违约金、知识产权授权费用、损害赔偿、罚金等，也有可能导致公司的知识产权或相关权利、授权被宣告无效或撤销，还有可能对公司的名誉造成影响。

四、重大违规事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现公司存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

根据公司 2024 年半年度报告，2024 年 1-6 月公司主要财务数据及指标如

下所示：

单位：万元

主要会计数据	2024年1-6月	2023年1-6月	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	21,958.69	30,788.83	-28.68
归属于上市公司股东的净利润	-23,812.99	-10,378.53	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,039.73	-17,518.44	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-17,765.28	-15,787.78	不适用
主要会计数据	2024年6月30日	2023年6月30日	本期末比上年同期末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	331,511.32	354,892.49	-6.59
总资产	376,828.55	411,208.90	-8.36
主要财务指标	2024年1-6月	2023年1-6月	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益(元/股)	-0.59	-0.26	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.59	-0.26	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.65	-0.44	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-6.94	-2.70	减少4.24个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-7.59	-4.56	减少3.03个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	126.07	86.94	增加39.13个百分点

报告期内，公司实现营业收入 21,958.69 万元，较上年同期减少 28.68%，其中芯片类营业收入为 16,335.60 万元，较上年同期增长 8.51%，解决方案类营业收入为 5,617.34 万元，较上年同期下降 64.14%。一方面，是受宏观经济环境、电子政务市场和公司传统优势工控领域部分重要客户尚未恢复正常采购的影响；另一方面，随着龙芯芯片产品竞争力提升，芯片销售收入相应提高，公司调整销售策略，减少了整机型解决方案的销售。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润-23,812.99 万元，主要由

于营业收入和毛利率的下降、计提减值损失的增加和其他收益的减少所致。

报告期内，公司每股收益为-0.59 元/股，主要系报告期内的净利润下降所致。

报告期内，公司研发投入占营业收入的比例增加 39.13 个百分点，主要系报告期内研发投入的增加和营业收入的下降所致。

六、核心竞争力的变化情况

（一）公司的核心竞争力

1、长期坚持自主研发形成的技术和能力积累

龙芯中科是国内唯一坚持基于自主指令系统构建独立于 Wintel 体系和 AA 体系的开放性信息技术体系和产业生态的 CPU 企业。经过长期积累，形成了自主 CPU 研发和软件生态建设的体系化关键核心技术积累。

与国内多数集成电路设计企业购买商业 IP 进行芯片设计不同，龙芯中科坚持自主研发核心 IP，形成了包括系列化 CPU IP 核、GPU IP 核、内存控制器及 PHY、高速总线控制器及 PHY 等上百种 IP 核。报告期内，通过新一代 CPU、SOC 和桥片芯片项目研制的牵引，掌握了高带宽低延迟片间互联龙链技术，持续演进高性能 CPU 核、高能效 GPU 核、高速内存接口和 IO 接口的设计研发能力。

与国内多数 CPU 企业主要基于 ARM 或者 X86 指令系统融入已有的国外信息技术体系不同，龙芯中科推出了自主指令系统 LA，并基于 LA 迁移或研发了操作系统的核心模块，包括内核、三大编译器（GCC、LLVM、GoLang）、三大虚拟机（Java、JavaScript、.NET）、浏览器、媒体播放器、KVM 虚拟机等。形成了面向服务器、面向桌面和面向工控类应用的基础版操作系统。在报告期内，通过在国际开源社区生态建设、龙架构标准规范体系制定、紧密结合市场需求的产品软件等方面的持续研发投入，建立起完整的基础软件生态体系建设的技術能力，掌握了二进制翻译与系统兼容、高性能图形处理器驱动等关键技术，推动 LA 架构软件生态不断发展与完善。

与国内多数 CPU 设计企业主要依靠先进工艺提升性能不同，龙芯中科通过设计优化和先进工艺提升性能，摆脱对最先进工艺的依赖。通过自主设计 IP 核，

克服境内工艺 IP 核不足的短板。报告期内，针对 CPU、SOC 和桥片芯片的设计需求，基本完成多种工艺的 IP 核设计和验证。

上述在长期自主研发和产业化过程中形成的核心技术和能力积累使得龙芯中科可以在现有技术基础上形成快速升级迭代提高性能，可以大幅降低 CPU 等芯片研制成本，可以更好地满足客户定制化基础软硬件需求，可以更好地建设自主信息产业生态。

2、产业生态优势明显

龙芯中科坚持走自主创新与生态建设路线。公司经过持续积累形成自主指令系统架构 LA，自主研发了包括处理器核心在内的上百种核心模块，并在各核心技术领域积极进行知识产权布局，截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计已获授权专利 728 项。

龙芯中科是国内 CPU 企业中极个别可以进行指令系统架构及 CPU IP 核授权的企业，是极个别在股权结构方面保持开放、未被整机厂商控制的企业。为扩大龙架构的生态，2023 年开始龙芯中科将龙芯 CPU 核心 IP 开放授权给部分合作伙伴，支持合作伙伴研制基于龙芯 CPU 核心 IP 及龙架构指令系统的 SoC 芯片产品，已有多家企业推出基于龙架构处理器 IP 核的 SoC 芯片产品。同时在多个高校推动龙架构人才生态建设，报告期内已有高校基于龙架构完成教学芯片流片并应用于教学当中。

龙芯产品竞争力的不断提升与市场应用持续辐射产业链，目前与公司开展合作的厂商达到数千家，下游开发人员达到数十万人，基于龙芯处理器的自主信息产业生态体系正在逐步形成。

3、团队优势

龙芯中科长期坚持“又红又专，红重于专”的人才选用和培养标准，在长期发展过程中锻造了一支有灵魂、有战斗力、能啃硬骨头的团队。龙芯团队坚持为人民做龙芯的根本宗旨，坚持自力更生、艰苦奋斗的工作作风，坚持实事求是的思想方法。在长期的研发和产业化实践中，团队在处理器研发、基础软件研发、结合客户需求的定制化开发等方面形成了深厚的技术积累。截至报告期末，公司

员工中 68.27%为研发技术人员，且研发技术人员中 45.19%拥有硕士及以上学历，为公司持续的技术与产品创新提供重要的人才基础。

（二）核心竞争力变化情况

本持续督导期间，保荐人通过查阅同行业上市公司及市场信息，查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈等，未发现公司的核心竞争力发生重大不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化

单位：万元

项目	2024年1-6月	2023年1-6月	变化幅度(%)
费用化研发投入	21,322.80	19,721.99	8.12
资本化研发投入	6,361.47	7,045.19	-9.70
研发投入合计	27,684.27	26,767.18	3.43
研发投入总额占营业收入比例(%)	126.07	86.94	增加 39.13 个百分点
研发投入资本化的比重(%)	22.98	26.32	减少 3.34 个百分点

公司持续加大研发投入，加速研发迭代。报告期内公司研发投入为 27,684.27 万元，同比增长 3.43%，公司不存在研发投入总额变化较大的情况。

（二）研发进展

1、在研项目情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司在研项目的具体进展如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	芯片研发项目 A	不适用	571.90	20,565.80	完成高质量等级服务器芯片的产品验证	面向服务器市场的高性能多核处理器芯片产品	国内先进水平	数据中心、云计算以及高性能计算等领域
2	芯片研发项目 B	不适用	1,950.19	5,830.44	推进多款工控 SoC 芯片产品的设计研发、初样验证、正样验证及产品化工作，其中 2K3000 初样交付流片	面向工控和终端市场的 SoC 芯片产品，集成 2 个处理器核，集成 PCI E3.0、SATA3.0、USB 3.0 等接口，集成自研 3D GPU 以及 GMAC 接口和其他常用接口	国内先进水平	工业控制与终端等领域
3	芯片研发项目 C	不适用	78.62	1,289.03	启动下一代处理器配套桥片的研究	适配龙芯系列处理器芯片，集成自研 GPU，及丰富的外围接口	国内先进水平	龙芯 3 号系列处理器配套桥片
4	芯片研发项目 D	不适用	426.95	2,917.51	推进多款模拟芯片产品化工作，	适配龙芯 CPU 的模拟	国内先进	龙芯 CPU 配套

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
					电源芯片进行降本优化	芯片	水平	模拟芯片,和CPU一起,提供全套自主可控解决方案,应用于服务器、桌面、工控等领域
5	芯片研发项目 E	不适用	2,113.89	9,346.57	完成 3A6000 产品的正样验证,启动下一代桌面 CPU 产品的研发工作	面向桌面等市场的高性能处理器芯片产品	国内先进水平	桌面、笔记本等领域
6	芯片研发项目 F	不适用	156.10	9,041.28	完成研制,达成设计目标	面向桌面、笔记本市场的高性价比多核处理器芯片产品	国内先进水平	桌面、笔记本等领域
7	芯片研发项目 G	不适用	328.97	2,008.42	推进正样产品化	面向工控市场的 SoC 芯片产品,集成 1 个或多个低功耗嵌入式处理器核,集成多种工业控制接口	国内先进水平	工业控制
8	芯片研发项目 H	不适用	239.75	1,878.99	进行多款 MCU 芯片的产品化工作,以及搭建电机应用升级款芯片初样验证环境	结合市场应用,推出国内领先水平的 MCU 产品	国内先进水平	智能家居、五金电子等领域

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
9	芯片研发项目 I	不适用	2,293.10	4,283.97	完成新一代 16 核以上产品的回片后基础测试	面向服务器市场的高性能多核处理器芯片产品，在原有服务器芯片基础上改进片间互连，提升接口速率，提高处理器性能 50%以上	国内先进水平	数据中心、云计算以及高性能计算等领域
10	芯片研发项目 J	不适用	63.17	63.17	完成新研芯片规格定义和方案论证，展开详细设计	面向打印机市场的系列化的主控 SoC 芯片产品	国内先进水平	打印机、一体机等领域
11	关键核心技术研发项目 B	不适用	2,379.23	10,928.30	进行第二代技术研发，完成硅前验证并交付流片	满足图形处理和通用计算的要求	国内先进水平	集成至龙芯桥片或处理器中，提升系统图形处理能力
12	关键核心技术研发项目 C	不适用	5,914.15	11,558.86	片间互连及多品类的高速接口完成流片，进行硅后测试验证	持续提高高速接口物理层传输速率，提高芯片间数据收发速度，并逐步拓展高速接口协议兼容性	国内先进水平	用于各类芯片间或芯片内互连
13	关键核心技术研发项目 E	不适用	70.90	94.24	完成能效核的初版设计和仿真验证，验证芯片已交付流片	进一步提高中高端处理器核的能效，重点在功耗的优化，达到市场同	国内先进水平	集成至龙芯系列处理器中，可应用于中高

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
						类型处理器核主流水平，给公司芯片产品提供核心竞争力支持		端工控、笔记本电脑、云终端等领域
14	关键核心技术研发项目 F	不适用	104.70	104.91	完成调研工作，开始设计工作	实现高性能、低功耗、高稳定性及良好扩展性的 DDR5 内存控制器，以满足未来计算需求	国内先进水平	用于通用处理器和内存之间的互连
15	关键核心技术研发项目 G	不适用	160.56	315.56	针对下一代高性能处理器核进行开发设计与优化，目前正在从代码开发阶段转向功能验证与物理设计磨合阶段	实现更高性能处理核 IP，关注 IP 核的执行效率，在相同工艺下，性能较上一代进一步提升	国内先进水平	集成至龙芯系列处理器中，可应用于桌面 PC、服务器等领域
16	封装与测试技术研发	不适用	115.40	3,053.04	具备 CPU/SOC/MCU 等类别芯片的中测成测能力，并持续改进芯片良率	建立高性能芯片的封装测试实验平台	国内先进水平	高性能多核芯片封装
17	操作系统基础软件研发	不适用	3,681.00	33,557.85	在国际开源软件界，LoongArch 架构的开源生态进一步发展完善。Linux 内核、GCC 编译工具链、LLVM 编译器、Go 语言、Rust 语言、QEMU 系统、V8 引擎、.NET 编程框架、FFmpeg 音视频	完成对新研芯片的系统软件支持。在多个国际开源软件社区实现对 LoongArch 架构的支持。研制应用二进制兼容系统实现跨操作系统发行	国内领先水平，部分达到国际领先水平	桌面办公、服务器、嵌入式、物联网、云计算、大数据等领域

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
					<p>编解码加速库等大量重要的开源软件社区在最新版本中，继续以较高级别和较完善的程度实现对 LoongArch 架构的支持。Alpine、Debian 等重要开源操作系统社区正在研制 LoongArch 架构的原生发行版，预计会在后续版本周期发布 LoongArch 架构操作系统发行版持续组织修订完善《LA 架构 ABI 标准规范》《统一系统架构规范》，实现对最新芯片特性和软件功能的支持。更新发布龙芯打印驱动引擎、兼容存量 Web 应用的龙芯浏览器解决方案、龙芯二进制翻译系统、龙芯应用兼容框架、GPU 驱动等产品和解决方案，相关的应用和设备兼容性明显提高。研制龙芯自研第一代 GPU 核（在 2K2000 和 7A2000 等芯片中使用）的驱动产品升级版本，可显著提升典型场景下的三维图形性能</p>	<p>版的应用软件二进制兼容。研制打印驱动引擎实对 Linux 平台打印机的支持</p>		

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
18	3号系列解决方案研发	不适用	660.10	17,774.21	5000系列服务器完成双路与四路服务器研制，进入产品化以及批量推广阶段	基于龙芯系列芯片，开发面向终端和服务器的产品解决方案，其中终端类包括笔记本、台式机、一体机、云终端、自助机具等产品方案，服务器包括单、双、四路等低中高产品方案	国内先进水平	桌面与服务器类应用
19	2号系列解决方案研发	不适用	1,843.61	8,588.82	基于龙芯系列 SoC 芯片，根据实际应用场景需求，研发不同规格、功能的核心模块、开发板和解决方案，包括云终端、国产方案板、嵌入式模块、边缘控制器、分布式控制器、龙芯派、打印机控制器等，部分项目已实现了量产或小批量出货状态	基于龙芯系列 SoC 芯片，研发不同规格、功耗、应用场景的开发板或核心模块	国内先进水平	工业控制、电力、显控终端、边缘计算、云终端等领域
20	1号系列解决方案研发	不适用	257.99	3,720.47	研制多款基于 MCU 芯片的解决方案，包括电机驱动、超声波、智能门锁、智能水表等领域的解决方案，部分项目处于研发或产品化阶段，部分项目已实现量产或小批量出货状态	基于龙芯 MCU 芯片，开发具备高可靠性、高安全性、高扩展性行业解决方案，同时为合作伙伴提供相应的开发、测试工具，提高合作伙	国内先进水平	智能门锁、智能表计、智能家居、智能出行、电动工具等行业

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
						伴的行业竞争力		
21	教学实验箱解决方案研发	不适用	115.64	1,114.00	支持高校基于 LA 架构进行教学	基于龙芯芯片或者龙芯 IP 开发多款面向不同课程的计算机类课程教学实验设备	国内先进水平	高校、职校计算机类课程实验教学
22	3 号系列第四代产品解决方案	不适用	4,158.35	4,158.35	龙芯 3A6000 批量推广阶段，支持厂商推出了丰富多样的产品方案系列，包括台式机、一体机、笔记本、NUC 等方案，启动 6000 系列服务器研制工作	基于龙芯第四代系列芯片，开发面向终端和服务器的产品解决方案	国内先进水平	桌面与服务器类应用
合计	/		27,684.27	152,193.79	/	/	/	/

2、知识产权

公司在各核心技术领域积极进行知识产权布局，截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计已获授权专利 728 项，其中发明专利 572 项，实用新型专利 154 项，外观设计专利 2 项。此外，公司还拥有软件著作权 196 项，集成电路布图设计专有权 26 项。

报告期内获得的知识产权列表如下所示：

知识产权类型	本期新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	85	30	1015	572
实用新型专利	18	14	204	154
外观设计专利	0	1	2	2
软件著作权	19	21	198	196
其他	0	4	34	26
合计	122	70	1453	950

注：表格中的“其他”是指集成电路布图设计

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

本持续督导期间，保荐人通过查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈，基于前述核查程序，保荐人未发现公司存在新增业务。

九、募集资金的使用情况及是否合规

本持续督导期间，保荐人查阅了公司募集资金管理使用制度、募集资金专户银行对账单和募集资金使用明细账，并对大额募集资金支付进行凭证抽查，对募集资金专户执行函证程序，查阅募集资金使用信息披露文件和决策程序文件，实地查看募集资金投资项目现场，了解项目建设进度及资金使用进度，对公司高级管理人员进行访谈。

基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期间，公司已建立募集资金管理制度并予以执行，募集资金使用已履行了必要的决策程序和信息披露程序。报告期内，公司根据相关募投项目实际情况，经过谨慎的研究论证，拟将募集资金投资项目“先进制程芯片研发及产业化项目”达到预定可使用状态的时间由原计

划延期至 2025 年 6 月，拟使用的募集资金增加投资 15,000.00 万元（新增金额来自下述“高性能通用图形处理器芯片及系统研发项目”调减的募集资金 15,000.00 万元）；拟将募集资金投资项目“高性能通用图形处理器芯片及系统研发项目”达到预定可使用状态的时间由原计划延期至 2025 年 6 月，拟使用的募集资金调减投资 15,000.00 万元（调减金额用于上述“先进制程芯片研发及产业化项目”增加的募集资金 15,000.00 万元），该事项已经公司董事会、股东大会审议通过，并于 2024 年 4 月 27 日披露了《龙芯中科关于部分募集资金投资项目延期及调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告（2024-020）》。

基于前述检查，保荐人未发现违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况如下：

2024 年 1-6 月，公司控股股东、实际控制人未发生减持行为。2024 年 1-6 月，公司控股股东北京天童芯源科技有限公司（以下简称“天童芯源”）通过上海证券交易所集中竞价交易方式合计增持 54,700 股，截至 2024 年 6 月 30 日，天童芯源持有公司的股份数量为 86,468,678 股，占公司总股份的 21.56%。

2024 年 1-6 月，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在持股变动情况。截至 2024 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结的情形。

十一、保荐人认为应当发表意见的其他事项

2024 年 1-6 月，公司营业收入为 21,958.69 万元，较上年同期下降 28.68%，其中芯片类营业收入为 16,335.60 万元，较上年同期增长 8.51%，解决方案类营业收入为 5,617.34 万元，较上年同期下降 64.14%。

2024 年 1-6 月，公司归属于上市公司股东的净利润为-23,812.99 万元，上年同期为-10,378.53 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为

-26,039.73 万元，上年同期为-17,518.44 万元，主要系公司营业收入和毛利率的下降、计提减值损失的增加和其他收益的减少所致。

保荐人已在本报告之“三、重大风险事项”之“（一）业绩大幅下滑或亏损的风险”对相关风险进行提示。未来，保荐人将督促公司做好信息披露工作，及时、充分地揭示经营风险，切实保护投资者利益，亦提醒投资者特别关注行业周期波动及市场环境变化带来的投资风险。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于龙芯中科技术股份有限公司 2024
年半年度持续督导跟踪报告》之签署页)

保荐代表人:


陈熙颖


何洋

